

非破壊で多層回路基板のCuパターンを分離、抽出します。

回路基板のCu箔パターン撮影および画像のCADデータ化の受託サービス開始

Started to accept Cu pattern photography for multilayer electronic circuit boards

概要

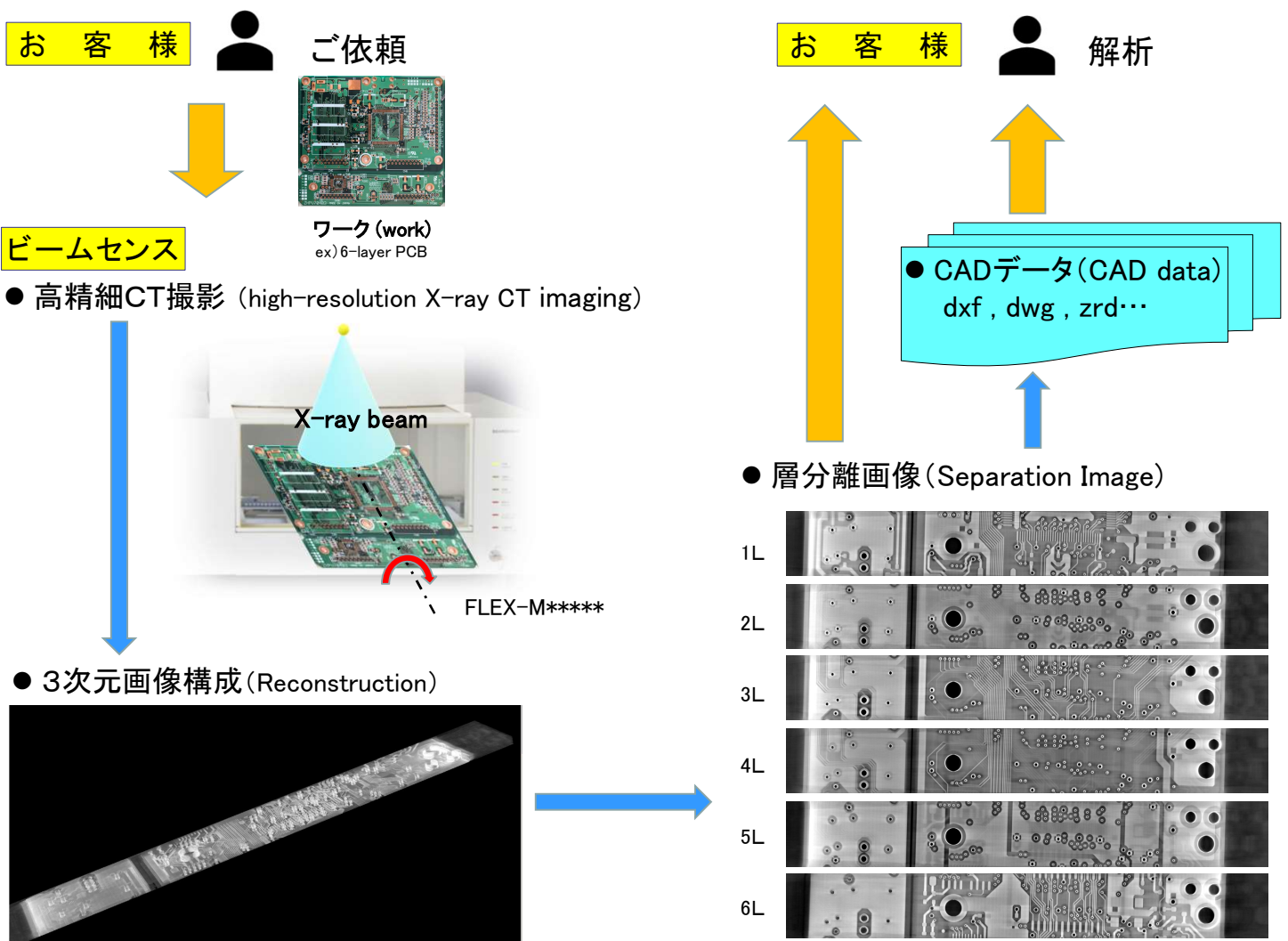
- 電子回路基板をX線CTシステムにて撮影、非破壊で層分離し、Cu箔パターンを層ごとにX線画像としてご提供します。
- 各のCu箔パターンイメージはdxfやdwg、zrdなどのCADデータに変換し、ご提供できます。
- CT撮影には弊社高精細CTシステムを使用し、これまでにない高精細な分離画像を提供できます。

課題

- 多層基板の配線や金属パターンを解析するにはプリント基板を1層ごとに切削し目視(可視光)検査やX線透過画像検査を実施していました。
- これらの方法ではプリント基板を破壊するので、貴重な基板等の解析は困難でした。
- 一方、従来のX線CT撮影では解像度や濃度分解能の制約で多層プリント基板の層分離は困難でした。

解決

- 高精細CT撮影受託サービスのご利用により非破壊でプリント基板の層分離データをご提供します。



※ 詳細は【技術紹介】高精細CT撮影による多層基板の非破壊分離をご参照ください。

【お問い合わせ先】

株式会社ビームセンス

BEAMSENSE CO., LTD.

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-19-16

TEL/FAX: 06-6384-9563 URL: <http://beamsense.co.jp/>